

三安光电股份有限公司关于上海证券交易所对公司收购股权相关事项的监管工作函的回复公告

证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临2025-054

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三安光电股份有限公司(以下简称“本公司”)近日收到上海证券交易所《关于三安光电股份有限公司收购股权相关事项的监管工作函》(上证公函【2025】1185号),现就相关问题回复公告如下:

问题1:
公告显示,标的公司为全球知名LED企业,主营汽车车灯、相机闪光灯和特种照明等领域LED产品的制造和销售。标的公司于2022年申请破产保护,当年10月完成重组程序后正常开展经营。但2024年标的公司营业收入5.89亿美元、亏损0.67亿美元,2025年第一季度继续亏损0.17亿美元,主要系标的公司部分工厂产能利用率低、各项采购价格较高、期间费用较高等原因所致。

请公司:(1)列示2023年至2025年第一季度标的公司前五名客户、供应商情况,包括名称、交易内容及金额、成立时间及合作开始时间,就变动的较大之处说明具体原因;(2)结合标的公司各项成本、费用的具体构成,分析说明标的公司相关成本、费用较高的原因及合理性,与同行业公司是否存在明显差异;(3)补充披露标的公司各工厂所在地、主要生产内容、设计产能及实际产能利用率,具体分析产能利用率低下的原因及合理性;(4)结合上述问题以及破产重整关于债务减免等具体安排,说明标的公司在完成重组后持续亏损的原因及合理性,是否存在其他未披露事项或安排。

【回复】
一、列示2023年至2025年第一季度标的公司前五名客户、供应商情况,包括名称、交易内容及金额、成立时间及合作开始时间,就变动的较大之处说明具体原因

(一)主要客户
2023年至2025年一季度,标的公司前五名客户基本情况如下:

序号	客户名称	成立时间	合作时间	主要交易内容	2025年1-3月				2024年度				2023年度			
					金额	占比	排名	占比	金额	占比	排名	占比	金额	占比	排名	占比
1	客户一	40年以上	35年以上	LED封装	0.19	13.53	1	0.04	15.94	1	1.03	17.77	1	1	1	1
2	客户二	40年以上	20年以上	特种照明器件及模组	0.17	12.03	2	0.71	12.35	2	0.70	11.78	2	2	2	2
3	客户三	40年以上	20年以上	LED封装及封装器件及模组	0.13	8.90%	3	0.47	7.93%	4	0.60	10.06	3	3	3	3
4	江西立达光电有限公司	2018	6年以上	特种照明器件及模组	0.08	5.33%	4	0.43	7.23%	5	0.43	7.14%	4	4	4	4
5	客户五	40年以上	10年以上	LED封装及封装器件及模组	0.07	4.69%	5	0.52	8.78%	3	0.55	9.20%	5	5	5	5
前五名客户合计					0.63	44.78	-	3.07	52.12	3	3.31	56.33	-	-	-	-

标的公司前五大客户收入合计占比分别为56.33%、52.12%和44.78%,其中2025年1-3月前五名客户收入合计占比有所下降主要因客户业务正常季节性波动。综上,标的公司的主营客户合作期限较长,客户粘性较强,2023年至2025年一季度前五大客户未发生重大变动。

(二)主要供应商
2023年至2025年一季度,标的公司前五名供应商基本情况如下:

序号	供应商名称	成立时间	合作时间	交易内容	2025年1-3月				2024年度				2023年度			
					金额	占比	排名	占比	金额	占比	排名	占比	金额	占比	排名	占比
1	江西同洲光电有限公司	2004	10年以上	封装外包	0.15	12.27	1	0.51	9.35%	1	0.60	9.98%	1	1	1	1
2	福建天光电有限公司	2013	10年以上	封装外包	0.08	6.20%	2	0.23	4.29%	2	0.29	4.84%	2	2	2	2
3	玉晶光电股份有限公司	1989	10年以上	晶片	0.04	3.29%	3	0.18	3.31%	3	0.17	2.89%	3	3	3	3
4	同联电子工业股份有限公司	1974	10年以上	引线框架、金、铜线等	0.04	2.97%	4	0.17	3.18%	4	0.11	1.85%	6	6	6	6
5	供应成五	40年以上	10年以上	黄金等	0.03	2.55%	5	0.12	2.18%	6	0.12	1.90%	5	5	5	5
6	供应成六	40年以上	10年以上	封装外包	0.03	2.27%	7	0.15	2.77%	5	0.14	2.22%	4	4	4	4
前五名供应商合计					0.34	27.40	-	1.24	22.90	5	1.36	26.04	-	-	-	-

2023年至2025年一季度,标的公司前三大供应商均未发生变化,其他主要供应商排名小幅变动主要系标的公司原材料或服务采购按各年正常波动所致。标的公司前五大供应商的合计采购占比分别为22.22%、22.90%和27.47%,其中2025年1-3月前五大供应商占比比上升主要系正常季节性波动。综上,标的公司与主要供应商保持良好的合作关系,2023年至2025年一季度标的公司主要供应商未发生重大变动。

二、结合标的公司各项成本、费用的具体构成,分析说明标的公司相关成本、费用较高的原因及合理性,与同行业公司是否存在明显差异

2024年度和2025年一季度,标的公司成本、费用构成如下:

项目	2025年1-3月				2024年度			
	金额	占比	占比	占比	金额	占比	占比	占比
营业成本	1.24				5.43			
销售费用	0.08	0.38			0.30			
管理费用	0.07	0.30			0.38			
研发费用	0.13	0.68			0.68			
财务费用	0.02	0.10			-0.09			
净利润	-0.07	-0.35			-0.69			

注:本回复财务报表数据来源于标的公司提供的未经审计的模拟财务报表,模拟口径具体参见本回复之“问题3”之“一”,模拟财务报表根据国际会计准则编制,下同。

(一)成本构成分析
2024年度和2025年一季度,标的公司营业成本分别为5.43亿美元和1.24亿美元,标的公司营业成本构成如下:

项目	2025年1-3月				2024年度			
	金额	占比	占比	占比	金额	占比	占比	占比
直接材料	0.06	53.14%			3.11	57.23%		
直接人工	0.00	6.48%			0.22	3.95%		
制造费用	0.09	40.27%			2.00	36.82%		
合计	1.24	100.00%			5.43	100.00%		

注:上表数据来源于标的公司提供的未经审计的财务数据,由于本次交易范围不包含标的公司部分主要原材料工厂,因此上表数据针对部分主要原材料的料工费进行模拟调整。

公司营业成本包括直接材料成本、直接人工成本及制造费用,其中制造费用包含厂房租金、间接人工、设备折旧及维修、IT等。公司营业成本构成波动较小。标的公司营业成本率较高,毛利率较低,标的公司及可比公司毛利率情况如下:

公司简称	2025年1-3月				2024年度			
	金额	占比	占比	占比	金额	占比	占比	占比
AMS-OSRAM	25.37				25.00			
Lg Innotek	7.46				8.22			
Signify	30.75				40.47			
国瑞光电	12.09				11.46			
瀚宇博仁	13.08				18.62			
瑞丰光电	25.83				23.27			
聚飞光电	22.73				26.80			
华灿光电	5.83				-1.61			
聚源光电	13.07				16.67			
聚和光电	16.42				12.70			
三安光电	16.23				13.80			
行业平均	17.93				17.59			
标的公司	12.06				7.80			

数据来源:wind。
标的公司毛利率低于行业平均水平,主要系制造费用及部分主要原材料成本较高所致。标的公司自产部分主要原材料,因工厂产能利用率不足以及厂房租金、人工、设备折旧、IT等成本较高导致标的公司部分主要原材料成本较高。经本公司初步判断,本公司生产的部分主要原材料低于标的公司同类原材料工厂成本一半以上,考虑到本次交易范围不包含标的公司部分主要原材料生产工厂,因此标的公司模拟报表基于此假设编制。

标的公司及可比公司2024年度料工费占营业收入比例情况如下:

公司简称	项目	直接材料				直接人工				制造费用			
		金额	占比	占比	占比	金额	占比	占比	占比	金额	占比	占比	占比
国瑞光电	LED封装及封装产品	61.61%				5.18%				16.82%			
瀚宇博仁	LED封装及封装产品	64.88%				6.63%				11.03%			
瑞丰光电	LED封装及封装产品	58.02%				/				/			
聚飞光电	LED封装及封装产品	58.26%				/				/			
华灿光电	LED封装及封装产品	42.48%				/				/			
聚源光电	LED封装及封装产品	34.71%				/				/			
聚和光电	LED封装及封装产品	40.80%				/				/			
三安光电	LED封装及封装产品	24.91%				/				19.40%			
行业平均		48.41%				5.91%				15.76%			
标的公司		52.59%				5.40%				33.97%			

注:AMS-OSRAM无法获取其料工费数据,部分A股可比公司直接人工和制造费用占比无法获取。

标的公司制造费用占营业收入的比例高于同行业平均水平,主要系:(1)标的公司境外工厂厂房租金、人工、设备折旧及维修、IT等成本较高,前述成本费用占制造费用一半左右;(2)因产能利用率不足导致分摊成本较高所致,产能利用率较低的原因详见本回复之“问题1”之“三”。

(二)费用构成分析
2024年度及2025年一季度,标的公司费用构成如下:

项目	2025年1-3月				2024年度			
	金额	占比	占比	占比	金额	占比	占比	占比
销售费用	0.08	5.67%			0.38	6.39%		
管理费用	0.07	4.06%			0.30	5.03%		
研发费用	0.13	9.22%			0.68	11.21%		
财务费用	0.02	1.42%			0.18	3.06%		
合计	0.30	21.28%			1.51	25.69%		

由于存在较高的销售费用、研发费用及财务费用,导致标的公司费用率高于行业平均水平,标的公司与可比公司的费用率情况如下:

公司简称	项目	2025年1-3月				2024年度			
		金额	占比	占比	占比	金额	占比	占比	占比
AMS-OSRAM	1.41%	23.53%	4.47%	2.11%	1.08%	0.81%	0.57%	0.81%	1.85
Lg Innotek	/	1.46%	3.03%	4.19%	2.53%	0.80%	1.27%	0.77%	1.12%
Signify	/	4.78%	4.51%	7.51%	5.26%	6.67%	5.16%	1.58%	5.17%
国瑞光电	/	4.33%	0.07%	7.63%	4.63%	5.20%	6.96%	1.57%	5.46%
瀚宇博仁	12.29%	5.11%	5.07%	5.40%	6.47%	4.70%	5.90%	4.49%	6.21%
瑞丰光电	12.22%	5.50%	5.24%	6.22%	6.71%	5.38%	6.57%	4.69%	4.38%
聚飞光电	/	-	-	-	-	-	-	-	-
华灿光电	5.98%	-	-	-	-	-	-	-	-
聚源光电	/	4.1%	10%	42%	0.00%	201%	152%	56%	1.12%
聚和光电	/	10.91%	12.53%	37.97%	12.11%	15.60%	13.94%	6.23%	10.40%
三安光电	/	10.51%	13.24%	17.62%	13.87%	13.46%	16.57%	5.47%	12.07%
合计	/	30.25%							

标的公司主要生产化合物半导体材料与器件的研发、生产及销售,以外延片、芯片为主业。LED业务主要包括LED芯片和LED应用(包括车灯组件和车灯等)。LED芯片可广泛应用于照明、显示、车灯、背光、农业、医疗AI/AR眼镜等众多领域,下游客户主要为LED封装厂商。LED应用的主要产品为LED车灯、室内灯和氛围灯等,下游客户主要为汽车主机厂。本公司LED封装的生产环节主要涵盖LED外延制造、LED芯片制造和LED车灯、LED外延芯片制造基地分布于厦门、芜湖、泉州、天津及赣州。LED车灯产能分布于芜湖、重庆及英国。此外,本公司集成电路业务包括射频前端、电力电子、光技术三大方向,主要产品为射频模块、SAW滤波器芯片、功率芯片、半导体激光器,广泛应用于移动终端、新能源汽车、充电桩、光伏储能、无人驾驶、机器人、智能穿戴、AI/AR等众多领域。

(二)标的公司经营业绩改善的具体措施和具体影响

1.原材料降本
大幅降低部分主要原材料成本。在部分主要原材料生产外包方面,标的公司已进行部分外包,同时积极寻求成本优势更强的供应商进行合作,下游终端客户认证正在逐步进行,待验证逐步完成后,部分主要原材料将全部外包,大幅降低生产成本。根据标的公司的测算,部分主要原材料生产外包成本预计比目前成本下降一半以上,每年预计节省的成本超过4,000万美元,预计将在2026年度达成目标降本计划的一半(因2026年度预计节省成本2,000万美元,在2027年度达成目标降本计划,上述原材料降本工作存在一定不确定性,敬请投资者注意风险)。

2.芯片和封装制造环节降本
在新加坡工厂LED芯片生产环节和马来西亚工厂LED芯片封装环节,采取积极降本措施对影响营业成本较大的项目进行优化,具体措施包括优化工艺、使用更环保材料、采购设备升级换代、能源系统提升等,进一步降低生产成本,每年预计节省的成本超过1,500万美元,预计将在交割完成后的12个月内陆续达到目标降本计划。

3.IT费用降本
标的公司目前IT费用等其他综合成本较高。本公司与标的公司IT系统类似,将通过集

数据来源:wind。
注:AMS-OSRAM仅能获取销售、行政及一般费用指标,无法单独获取销售费用及管理费用指标。

2024年度及2025年一季度,标的公司管理费用率与行业平均水平相近,销售费用率高于行业平均水平主要系标的公司全球化经营的销售服务体系导致销售费用高所致,标的公司销售及行政管理费用率与境外可比公司AMS-OSRAM(12%-14%)相近;销售费用率与境外可比公司AMS-OSRAM相近,高于行业平均水平主要系标的公司产品矩阵丰富且以中高端为主,需要较大的研发投入,财务费用率高主要系标的公司存在借款且利率较高所致。三、补充披露标的公司各工厂所在地、主要生产内容、设计产能及实际产能利用率,具体分析产能利用率低下的原因及合理性

工厂所在地	主要生产内容	设计产能	2025年1-3月产能利用率		2024年产能利用率	
			产能	占比	产能	占比
新加坡	LED芯片封装	175万个			37.00%	40.00%
马来西亚	LED芯片封装	超过130万个			51.19%	60.32%
中国	LED模组封装	超过22万个			81.00%	70.00%

由于重组后标的公司股东为债权人银团,无长期经营公司,对标的公司资源投入不足,导致标的公司资金紧张,新产品开拓力度不够;此外,由于重组后债权人银团即开始对标的公司进行拆分出售,导致部分客户对标的公司信心不足,影响了对标的公司的订单分配比例,订单份额下降造成标的公司产量下降,进而导致产能利用率低。由于上述原因导致产能利用率低具有合理性。

交易协议签署后,标的公司主动与其主要客户进行了沟通,客户均明确表示支持本次交易。同时,本公司已启动跟标的公司主要客户的沟通工作,向客户说明收购目的、资金投入和经营改善优化措施,以增强客户信心,确保主要客户订单的稳定。此外,标的公司部分主要客户同时也是本公司客户,本公司可依托既有合作关系,确保交割后标的公司客户订单的稳定性。

四、结合上述问题以及破产重整关于债务减免等具体安排,说明标的公司在完成重组后持续亏损的原因及合理性,是否存在其他未披露事项或安排。

(一)标的公司破产重组关于债务减免的具体安排
2022年,标的公司及其部分关联公司根据美国破产法第11章向美国纽约南区破产法院申请破产保护。

1.重整申请之时,标的公司及其部分关联公司涉及的债务情况
(1)重整申请之时,由标的公司上层股权公司Bright Bidoce B.V.作为借款人向第三方债权人银团(以下简称“原债权人”)借款,包括定期贷款,金额约为16.08亿美元,以及循环贷款,金额约为0.88亿美元,总计约16.95亿美元(以下简称“BiCoCo贷款”)。BiCoCo贷款主要为向波罗2017年收购标的公司时的并购贷款,于2017年6月首次签订,预计2024年6月到期,利率每年调整,计算方式为伦敦同业拆放利率(Libor)+当年适用利率。截至2021年12月31日利率为“Libor+4.5%”。并购贷款常用于境外林木收购(LBO)中,通常由收购方以标的公司的资产、股权、信用为债权人提供担保或提供的方式取得贷款,收购完成后将贷款债务下沉到目标公司,由标的公司的资产、现金流、分红等支持偿还债务。

(2)由标的公司子公司Lumileds Singapore Pte. Ltd. 作为借款人向United Overseas Bank借款,金额约为0.28亿美元,以及由标的公司子公司Lumileds Malaysia Sdn Bhd作为借款人向Commerce International Merchant Bank借款,金额约为74万美元,总计0.28亿美元(以下简称“其他贷款”)。

2.重整计划主要安排
重整申请之后,标的公司及其部分关联公司从部分原债权人(以下简称“DIP债权人”)取得了自行管理经营控制权,“Debtor-in-possession, DIP债权人控制”,以在重整过程中能够开展正常经营活动。在重整过程中标的公司的总计使用1.75亿美元,主要用于支付重组费用、员工薪酬以及生产运营资金等。

BiCoCo贷款由16.95亿美元减至1.25亿美元,其他贷款保留。标的公司因业务运营与客户需求产生新的经营性债务不受影响,将在正常经营中以支付。标的公司重组前的股东阿波罗、飞利浦不再持有标的公司股权,原债权人以及DIP债权人(以下简称“债权人银团”)通过Stichting Administratiekantoor Aegletes持有标的公司100%股权。

(3)标的公司重组前后示意性债务变化:

项目	重组前		重组后	
	金额	占比	金额	占比
BiCoCo贷款	16.95		1.25	
DIP融资	1.75		1.75	
其他贷款	0.28		0.28	
总计	18.99		3.29	

(二)标的公司破产重组后持续亏损的原因及合理性
破产重组前,标的公司每年要承担17亿美元并购贷款(即BiCoCo贷款)带来的大额利息费用,标的公司2021年的各类利息费用约为1.13亿美元,负担沉重,加上全球宏观因素影响导致市场需求下降、原材料和制造成本上升等诸多不利因素,导致标的公司进入破产重组。

破产重组后,标的公司股东变更为债权人银团,无意长期经营公司,对标的公司资源投入不足,导致标的公司资金紧张、新产品开拓力度不够;此外,由于重组后债权人银团即开始对标的公司进行拆分出售,导致部分客户对标的公司信心不足,影响了对标的公司的订单分配比例,致使标的公司收入降低。标的公司产量下降导致产能利用率降低,制造费用成本不减,叠加标的公司部分主要原材料成本过高等因素,进一步抬升了标的公司生产成本并导致毛利率下降。同时,标的公司较高的销售费用、研发费用、财务费用以及重组拆分出售的相关费用,对于标的公司恢复以往业绩产生了不利影响。因此及破产重组后债务减少,标的公司已大幅减亏,但因上述原因,仍然持续亏损,重组后持续亏损具有合理性。

本公司已采取相关措施保障标的公司主要客户和订单的稳定性,具体措施请参见本回复之“问题1”之“三”相关内容。

(三)标的公司破产重组后不存在其他未披露事项或安排

经查阅相关资料,除上述导致标的公司破产重组后持续亏损的原因外,不存在其他未披露事项或安排。本公司拟联合境外投资人通过香港SPV向境外保险公司就卖方陈述与保证事项购买保证与赔偿保险(Warranties & Indemnities Insurance)以保护交割后潜在因违约事项造成的损失,上述事项涵盖了卖方于交割前披露、以往并购与重组相关的陈述与保证。当出现约定范围内的事项违约时,香港SPV将依据保险合同向保险公司索赔。保险合同尚未正式签订,保额尚未最终确定,敬请投资者注意风险。